



全球CSP资本开支上修，长鑫存储 LPDDR6量产在即

半导体行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年08月04日

- 分析师：庄宇
- SAC编号：S1050525120003
- 分析师：何鹏程
- SAC编号：S1050525070002

- 分析师：张璐
- SAC编号：S1050526010002
- 联系人：石俊烨
- SAC编号：S1050125060011

研究创造价值

九大CSP 2026年资本支出上修至8867亿美元，AI基建产业链全面受益

根据TrendForce，2026年全球九大云端服务供应商（CSP）总资本支出将同比大涨约90%至8867亿美元，2027年将进一步扩大至约1.3万亿美元（同比+49%），高基期下增速收敛并非投资趋缓。2026年AI服务器出货年增幅度从28%上调至近31%。北美五大CSP（谷歌、亚马逊、Meta、微软、甲骨文）合计占比近90%，各自资本支出大多翻倍；中国大陆CSP（字节跳动、腾讯、阿里、百度）合计同比大涨超80%，字节跳动投入力度最大。展望2027年，产业增长有望从以GPU扩张为主，转向AI服务器、液冷散热、先进封装、高速互联、电源和内存等基础设施全面升级，AI推理、Agentic AI、自研ASIC和新一代模型持续推升算力需求。

长鑫存储LPDDR6研发接近量产，移动端DRAM窗口期打开

根据Wccftech，长鑫存储LPDDR6芯片已基本完成研发验证阶段，接近正式量产。产品规格设计速率18000 Mbps，单die容量16Gb，低功耗和可靠性较前代LPDDR5X明显优化。当前三星、美光战略重心转向利润更高的HBM和服务器DRAM，为长鑫在移动端DRAM市场创造“空窗期”机遇。长鑫DRAM芯片已切入下游主流客户供应链，2025Q4全球DRAM市场份额达7.67%，跻身全球第四。苹果正积极游说美国政府，希望获得特别批准采购长鑫DRAM用于中国市场销售产品，以缓解传统DRAM供应紧张和议价权削弱的压力。预计2028年底长鑫全球DRAM产能占比有望提升至17%左右。

建议关注：长鑫科技、精测电子。

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026/8/2 股价	EPS			PE			投资评级
			2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	
300567.SZ	精测电子	191	0.29	1.21	2.04	658.62	157.85	93.63	未评级
688825.SH	长鑫科技	53.97	0.03	2.17	3.66	1799	24.87	14.75	买入

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）

目录

CONTENTS

1. 半导体板块周度行情分析
2. 行业高频数据
3. 行业动态
4. 公司公告

01 半导体板块周度行情分析

研究创造价值

1.1、周涨幅排行

7月27日-7月31日当周，海外龙头总体呈震荡分化态势。其中，QORVO领涨，涨幅为4.69%，环球晶圆领跌，跌幅为16.99%。

图表2：海外半导体龙头估值水平及周涨幅（%）

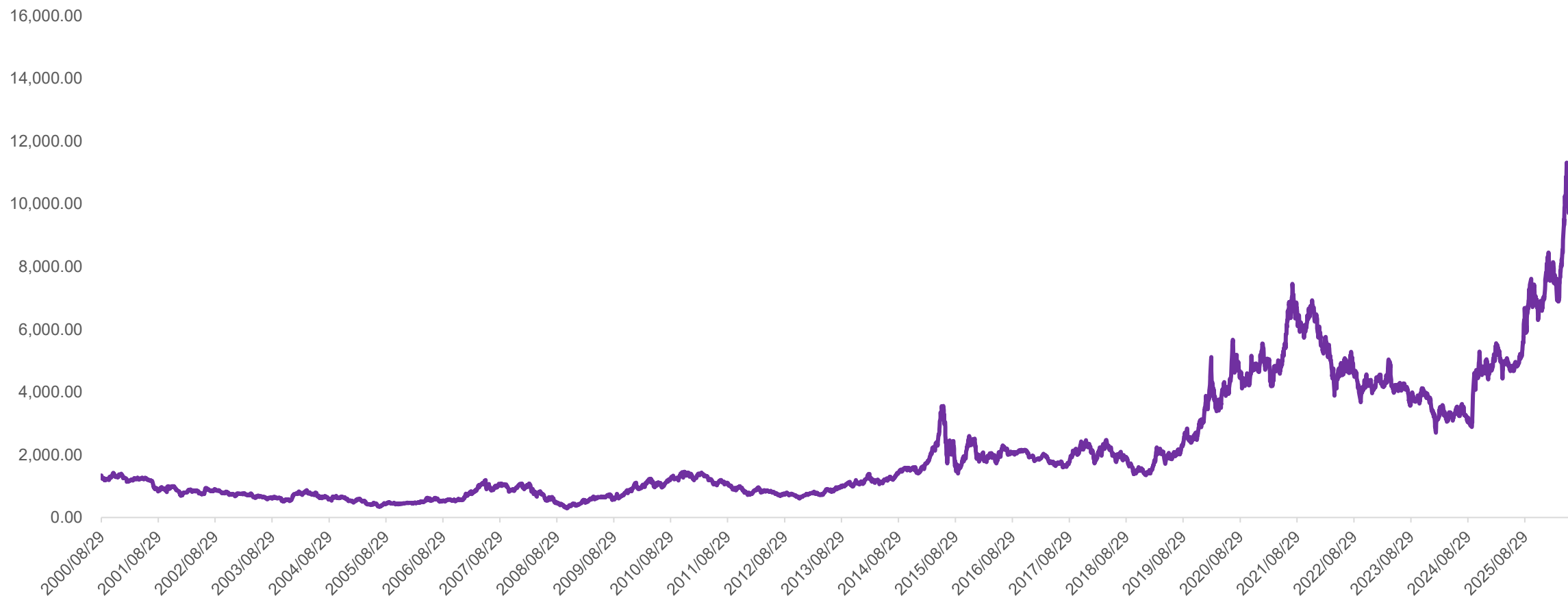
	证券代码	证券简称	国家/地区	市值（亿元）	PE(LYR)	PB(MRQ)	周涨跌幅（%）
处理器	INTC.O	英特尔 (INTEL)	美国	4549.69	-1704.00	5.20	-2.30
	QCOM.O	高通 (QUALCOMM)	美国	1549.91	27.97	5.60	-11.59
	AMD.O	超威半导体 (AMD)	美国	7764.10	179.10	12.04	-8.77
	NVDA.O	英伟达 (NVIDIA)	美国	48581.50	40.46	24.85	-2.94
存储	MU.O	美光科技 (MICRON TECHNOLOGY)	美国	9295.24	108.86	9.23	-10.63
模拟	TXN.O	德州仪器 (TEXAS INSTRUMENTS)	美国	2518.19	50.64	13.98	-0.87
	ADI.O	亚德诺 (ANALOG)	美国	1789.61	78.93	5.30	-1.20
	AVGO.O	博通 (BROADCOM)	美国	18520.31	80.08	21.12	1.93
	NXPI.O	恩智浦半导体 (NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	577.86	28.59	5.07	-14.89
射频	SWKS.O	思佳讯 (SKYWORKS)	美国	93.71	19.64	1.63	3.44
	QORVO.O	QORVO	美国	79.90	23.57	2.30	4.69
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	467.60	281.69	2.65	1.65
	ON.O	安森美半导体 (ON SEMICONDUCTOR)	美国	319.83	264.32	4.38	-5.99
	IFX.DF	英飞凌科技	德国	805.36	79.35	4.63	-4.25
光学	3008.TW	大立光	中国台湾	5277.71	24.81	2.86	2.93
半导体设备	AMAT.O	应用材料 (APPLIED MATERIAL)	美国	4030.69	57.60	16.86	-5.33
	LRCX.O	拉姆研究 (LAM RESEARCH)	美国	3666.49	50.47	29.40	-3.99
	KLAC.O	科天半导体 (KLA)	美国	2388.13	49.44	37.61	-13.16
	ASML.O	阿斯麦	荷兰	6415.50	56.98	25.89	-7.17
硅片	6488.TWO	环球晶圆	中国台湾	4087.87	55.91	4.38	-16.99
晶圆代工	2330.TW	台积电	中国台湾	683387.37	37.04	9.78	3.19
	GFS.O	格芯 (GLOBALFOUNDRIES)	开曼群岛	274.30	30.99	2.35	-6.61
化合物半导体	3105.TWO	稳懋	中国台湾	1248.50	73.71	3.05	-13.76
封装	ASX.N	日月光投资	中国台湾	783.20	60.69	7.17	-4.53
分销	ARW.N	艾睿电子 (ARROW ELECTRONICS)	美国	110.74	19.39	1.64	2.03
	AVT.O	安富利 (AVNET)	美国	72.87	30.34	1.47	-0.65

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.2、申万一级行业估值水平

7月27日-7月31日当周，申万半导体指数整体呈现下跌态势。7月31日，申万半导体指数为9261.73，周跌幅为11.42%。

图表3：近5年申万半导体指数

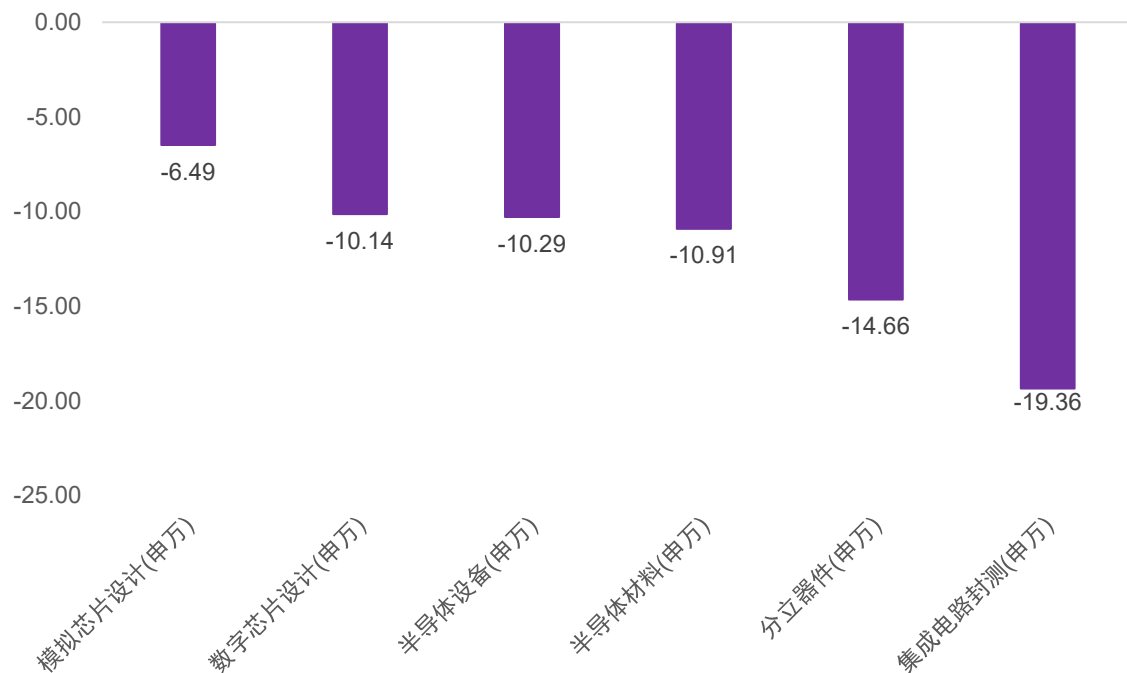


资料来源：wind，华鑫证券研究 注：按申万行业二级分类

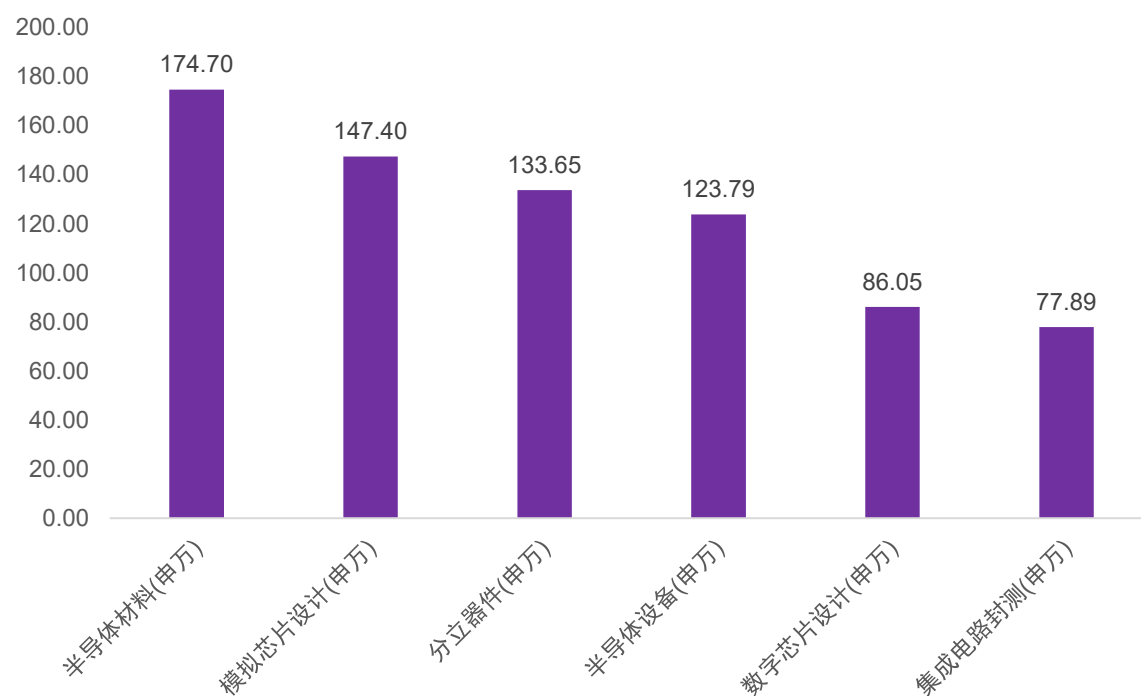
1.3、半导体细分板块周度行情梳理

半导体细分板块比较，7月27日-7月31日当周，半导体细分板块全部下跌。其中，模拟芯片设计板块跌幅最小，达到6.49%；集成电路封测板块跌幅最大，达到19.36%。估值方面，半导体材料、模拟芯片设计、分立器件板块估值水平位列前三。

图表4：7月27日-7月31日半导体主要指数周涨跌幅比较（%）



图表5：7月31日半导体主要指数市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

1.4、申万二级行业板块资金流向

上周申万行业资金流向情况：
电子化学品II板块主力净流入17.23亿元，主力净流入率为0.85%，在9个二级子行业中排第1名；通信设备板块主力净流出209.74亿元，主力净流入率为-2.49%，在9个子行业中排第9名。

图表6：7月27日-7月31日申万行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW电子化学品II	6,475,337.02	6,303,014.28	172,322.74	0.85	1
SW半导体	92,858,907.83	91,848,503.35	1,010,404.49	0.46	1
SW其他电子II	2,580,380.28	2,631,148.64	-50,768.35	-0.57	1
SW其他电源设备II	2,238,403.80	2,288,485.41	-50,081.61	-0.67	1
SW军工电子II	2,967,856.04	3,068,285.28	-100,429.24	-0.89	1
SW计算机设备	5,614,214.62	5,935,987.67	-321,773.05	-1.85	1
SW航天装备II	415,843.59	464,809.87	-48,966.28	-2.13	-5
SW消费电子	11,680,524.79	12,462,683.12	-782,158.33	-2.24	1
SW通信设备	39,761,374.21	41,858,760.91	-2,097,386.70	-2.49	1

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.5、半导体板块公司周涨幅前十股票

7月27日-7月31日当周，半导体板块公司周涨幅前十个股：风华高科，普冉股份，爱施德，长盈精密，维信诺，艾森股份，中芯国际，佳禾智能，华力创通，欧菲光，周涨幅分别为：22.70%，16.21%，13.11%，12.89%，12.87%，10.57%，10.06%，9.33%，8.64%，8.25%。

图表7：半导体板块公司周涨幅前十股票

证券代码	证券简称	市值（亿元）	EPS			PE			PB	周涨跌幅（%）
			2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E		
000636.SZ	风华高科	570.99	0.24	0.58	0.70	200.11	85.15	70.08	4.62	22.70
688766.SH	普冉股份	376.41	2.77	3.39	3.96	128.73	105.14	90.05	15.57	16.21
002416.SZ	爱施德	124.05	0.30	0.40	0.47	29.15	25.06	21.31	2.31	13.11
300115.SZ	长盈精密	375.46	0.44	0.60	0.89	56.08	45.79	30.88	4.51	12.89
002387.SZ	维信诺	96.80	-1.71	-1.40	-1.23	-3.37	-4.95	-5.65	3.71	12.87
688720.SH	艾森股份	65.92	0.38	-	0.86	196.92	-	86.52	6.40	10.57
688981.SH	中芯国际	5089.73	0.46	0.66	0.81	94.73	96.87	79.07	5.37	10.06
300793.SZ	佳禾智能	41.94	-0.41	-	-	-27.06	-	-	1.50	9.33
300045.SZ	华力创通	82.50	-0.10	-	-	-118.87	-	-	5.44	8.64
002456.SZ	欧菲光	252.41	0.01	-	-	152.16	-	-	4.84	8.25

资料来源：wind，华鑫证券研究

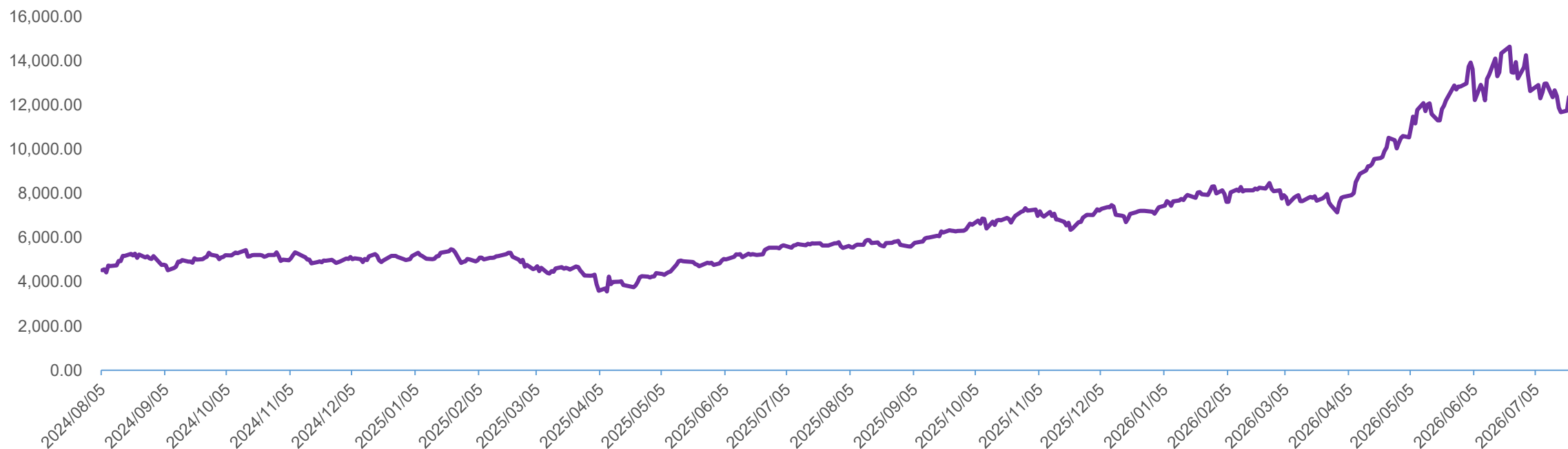
02 行业高频数据

研究创造价值

2.1、半导体：费城半导体指数

海外方面，7月27日-7月31日当周，费城半导体指数总体呈现震荡下跌的态势，2026年7月31日下跌至11311.08。更长时间维度上来看，2023年年底开始持续上涨。2024年上半年整体处于上升态势，7月出现大幅回调，8月处于震荡下行行情，9月出现探底回升，四季度总体处于震荡的态势。2025年一季度呈现先涨后跌的走势，4月后逐渐回升，二季度三季度均呈现震荡上行的态势。2026年七月以来，指数在6月达到阶段高点后持续回落，7月中旬触底后呈现震荡筑底的态势。

图表8：费城半导体指数近两年走势

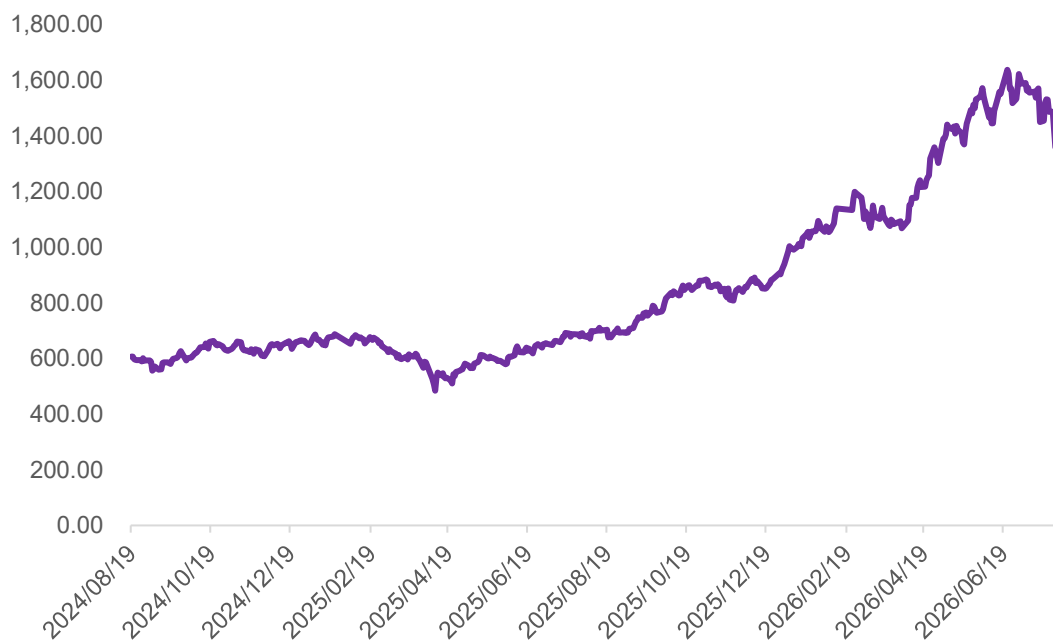


资料来源：wind，华鑫证券研究

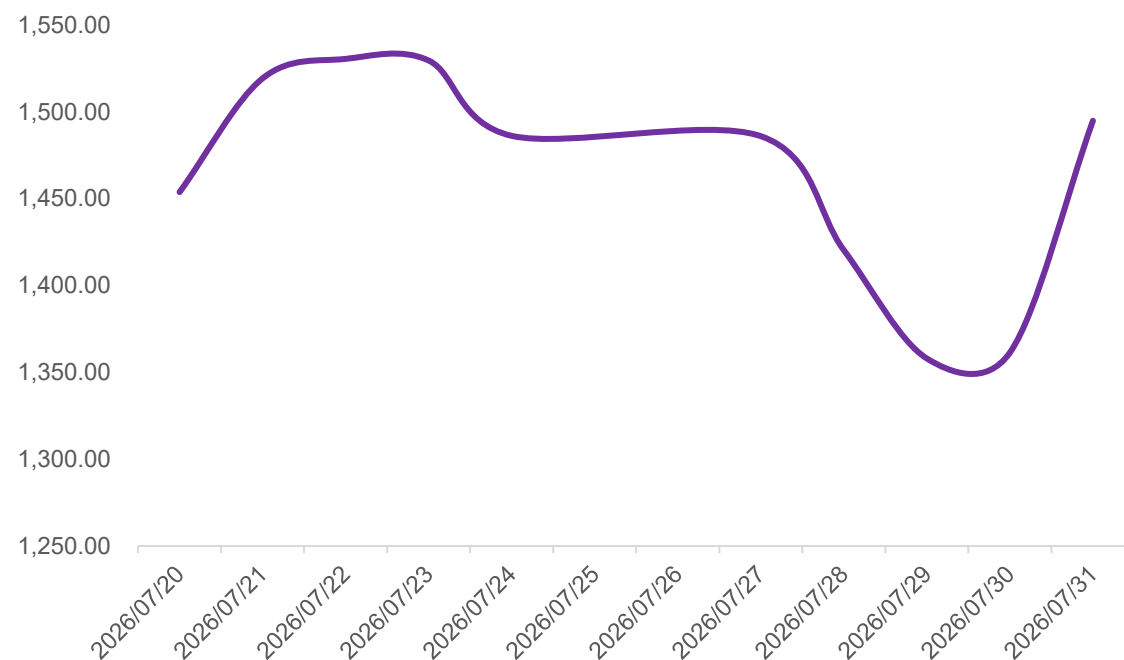
2.2、半导体：台湾半导体行业

此外，我们选取台湾半导体行业指数来观察行业整体景气。近两周来看，7月20日-7月31日两周，台湾半导体行业指数呈现震荡下降态势。近两年来看，2024年二季度台湾半导体指数呈现上涨的态势，随后进入震荡行情。2025年一季度台湾半导体指数进入下跌的行情，随后进入上行的趋势。2026年七月以来，指数在月初达到阶段高点后持续回落，呈现震荡下跌态势。

图表9：台湾半导体行业指数近两年走势



图表10：台湾半导体行业指数近两周走势



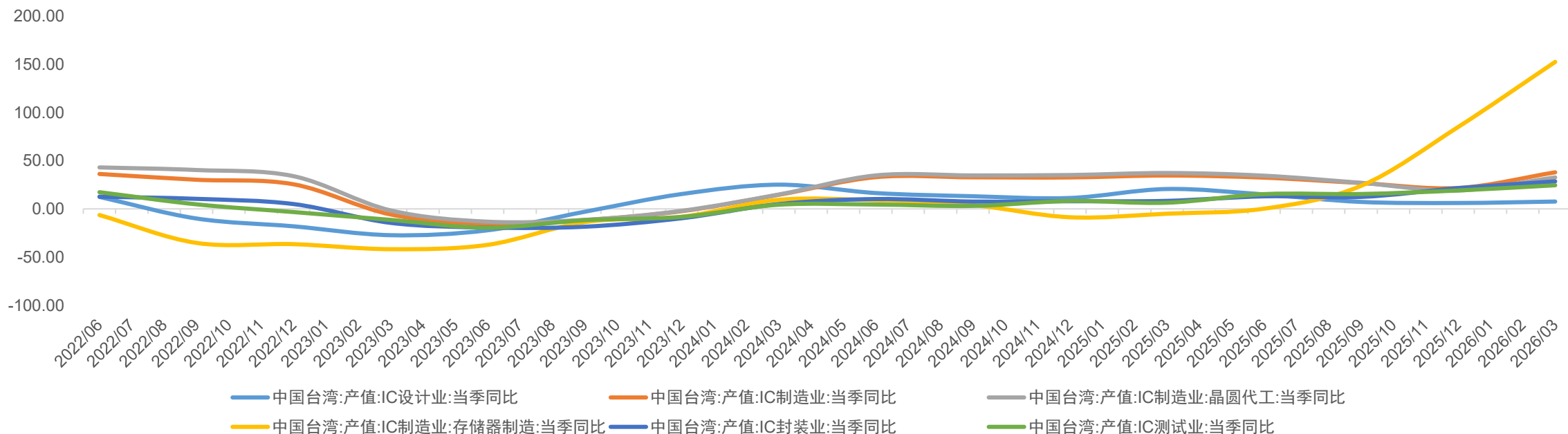
资料来源：wind，华鑫证券研究

2.3、半导体：中国台湾IC产值同比增速

我们可以通过中国台湾IC产值同比增速，将电子各板块合在一起观察：

中国台湾IC各板块产值同比增速自2021年以来持续下降，从2023年Q2开始陆续有所反弹，各板块产值降幅均有所收窄。IC板块整体表现不佳，主要因为消费电子需求差，导致IC设计下滑，加之2021年缺货、涨价导致的2022年库存水位上升。但随着AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动，2024年需求开始逐步回升。2025年，中国台湾IC设计、IC制造以及晶圆代工产值同比增速小幅下滑；中国台湾IC封装、测试业产值同比增速为维持平稳的增速；中国台湾存储器制造业进入下半年来，产值同比大幅提升。2026年一季度，中国台湾IC各板块产值同比增速全面上行。在AI算力需求持续旺盛及存储器行业周期复苏的推动下，2026年Q1中国台湾IC产业景气度显著上行。

图表11：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）



资料来源：wind，华鑫证券研究

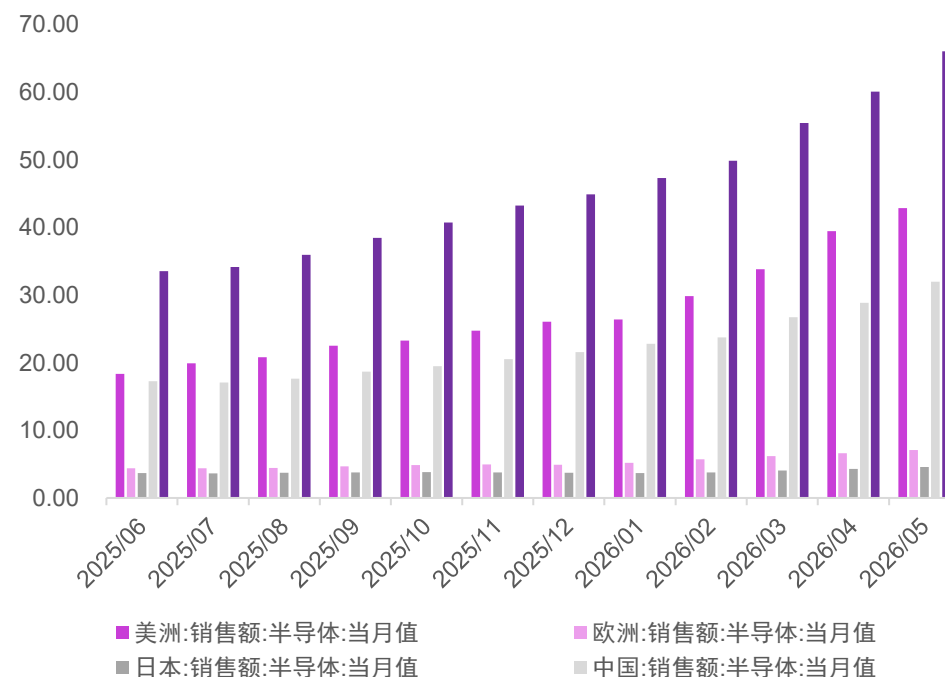
2.4、半导体：全球半导体销售额

全球半导体销售额自2024年年底出现小幅下降。2025年4月以来，全球半导体销售额呈现逐月攀升的态势，半导体行业景气度提升显著。2025年6月增速开始放缓，7-10月增速开始回升。2026年5月，全球半导体当月销售额为120.67亿美元，同比增长104.10%。其中，中国销售额为319.70亿美元，环比增长10.70%，占比达26.51%。

图表12：全球半导体销售额（单位：十亿美元）



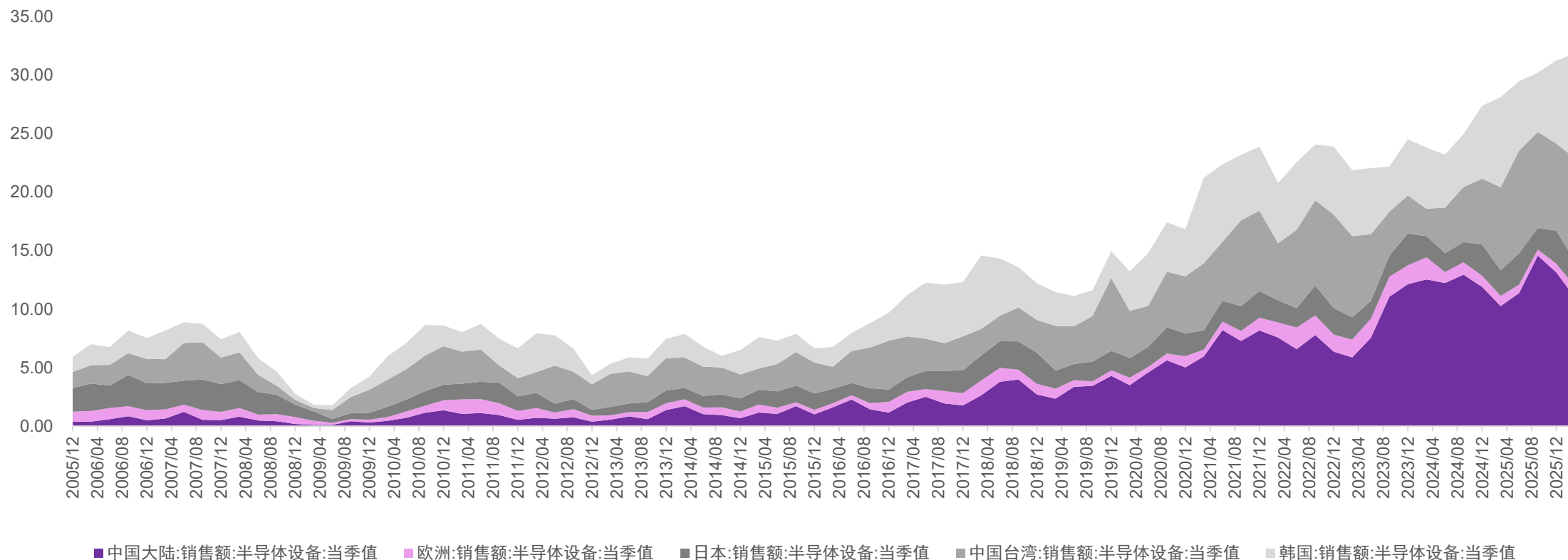
图表13：全球半导体销售额按地区划分（单位：十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2026年一季度，中国大陆半导体设备销售额达到109.9亿美元，同比增长7.12%，环比下降16.30%，占全球主要地区比重达34.56%。

图表14：全球半导体设备销售额（十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.6、半导体：中国进口半导体设备数量

从中国进口半导体设备数量的维度来看，2023年以来，中国的半导体设备进口数量整体呈现平稳的态势。2026年1-2月进口数量阶段性回落，3月起持续回升，6月达7583台，4-5月连续两月维持在较高水平，显示国内晶圆厂扩产需求旺盛。结合上文中国大陆半导体设备销售额攀升的趋势，我们认为国产设备正在逐步提升市场份额。

图表15：中国半导体设备及制造半导体器件或集成电路用装置进口数量（台）

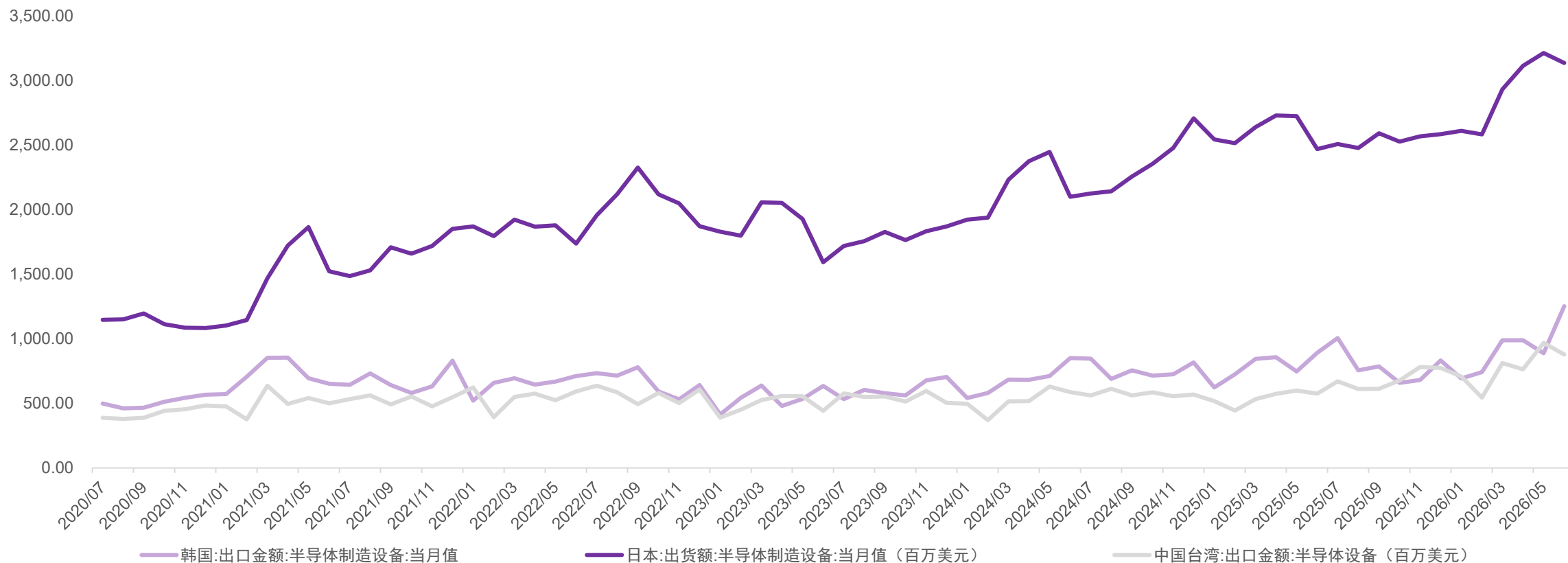


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.7、半导体：海外市场半导体设备出口额

从海外市场半导体设备出口额的维度来看，2019年以来，韩国和中国台湾的半导体设备出口金额整体维持平稳的态势，日本半导体设备出口额整体呈现上升趋势。2026年以来，日本半导体设备出口额持续攀升并创阶段新高；韩国出口额近期大幅回升，中国台湾出口额高位有所回落。

图表16：海外市场半导体设备出口金额（百万美元）



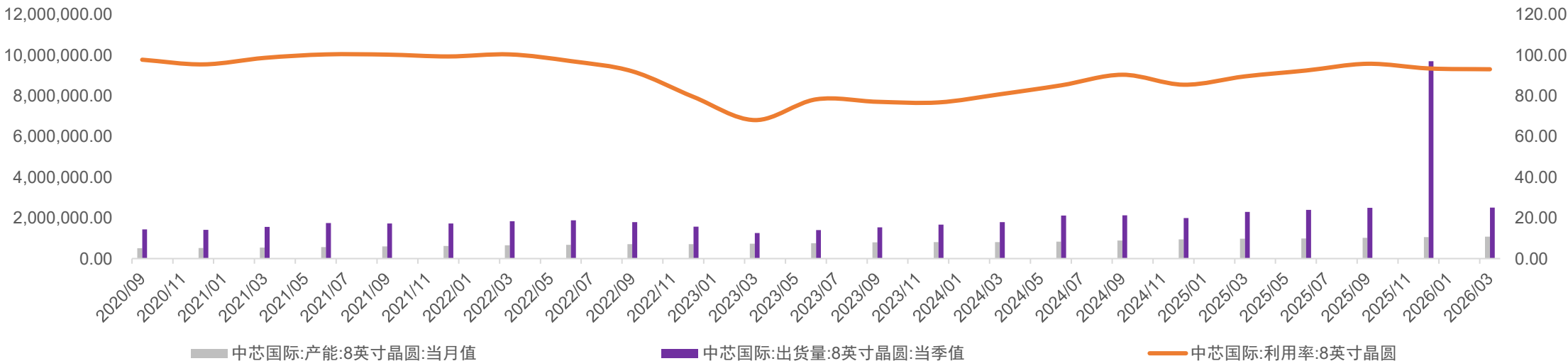
资料来源：wind，华鑫证券研究

2.8、半导体：晶圆制造

晶圆制造方面，2018年至2025年9月，国产晶圆代工厂商中芯国际8英寸晶圆月产能从约45万片稳步提升至约102.3万片，实现翻倍以上增长，并历经稳步爬升、加速扩张及快速扩产三个阶段，尤其在行业调整期间中芯仍坚持逆周期布局，为后续复苏储备了充足产能。

产能利用率清晰地映射行业周期，从2020 -2022年高景气期多次超过100%，到2023年下行期下滑至68.1%，随后自2023年第三季度起强劲反弹，至2025年第三季度已恢复至95.8%的高位，接近满产状态。在产能大幅扩张与利用率快速回升的共同推动下，季度出货量规模显著跃升，2025年第三季度达到近250万片，创历史新高，即便利用率未及上轮峰值，实际产出总量已远超以往。2026年一季度8英寸晶圆出货量达到约250.9万片，维持历史高位。整体来看，国产晶圆代工厂通过逆周期扩产把握了复苏机遇，出货规模的突破体现规模效应增强，也印证了汽车电子、工业控制、物联网等领域对成熟制程芯片需求的持续性与增长潜力。

图表17：国产晶圆代工厂产能、出货量、产能利用率数据（单位：片）



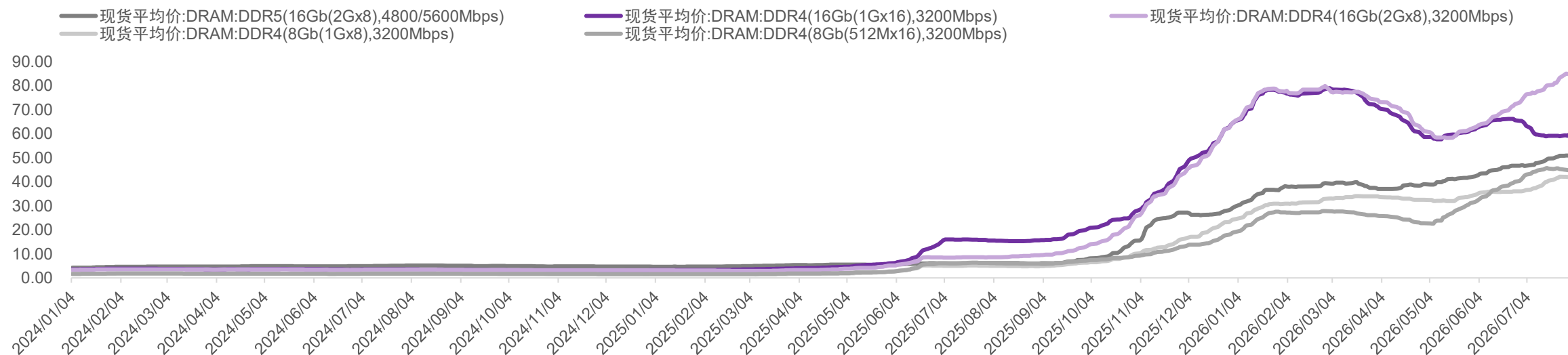
资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

存储芯片方面，由于AI存力需求提升以及海外大厂产能切换HBM等缘故，导致传统DRAM以及NAND类存储芯片价格大幅攀升。NAND方面：Wafer:512GbTLC现货均价从2024年3月底进入小幅回升，10月出现小幅下跌后变化趋于平缓，2025年3月以来小幅上涨，4月后价格略有下滑，7月后价格进入加速上涨阶段。2026年2月23日价格为17.95美元。

DRAM方面：DDR5(16Gb,4800/5600Mbps)现货均价自2025年以来呈现大幅上涨态势，2026年3月初约39.67美元，此后延续上涨，截至7月31日价格已达50.97美元。DDR4各规格产品分化运行，16Gb(2Gx8)3200Mbps现货价由6月18日的69.13美元进一步升至31日的85.22美元，16Gb(1Gx16)3200Mbps现货价由6月18日的66.00美元回落至7月31日的59.70美元。整体来看，在AI需求拉动及供给端产能转向HBM的背景下，DRAM价格整体延续分化上涨态势，主流规格持续走高，部分规格高位震荡回调。

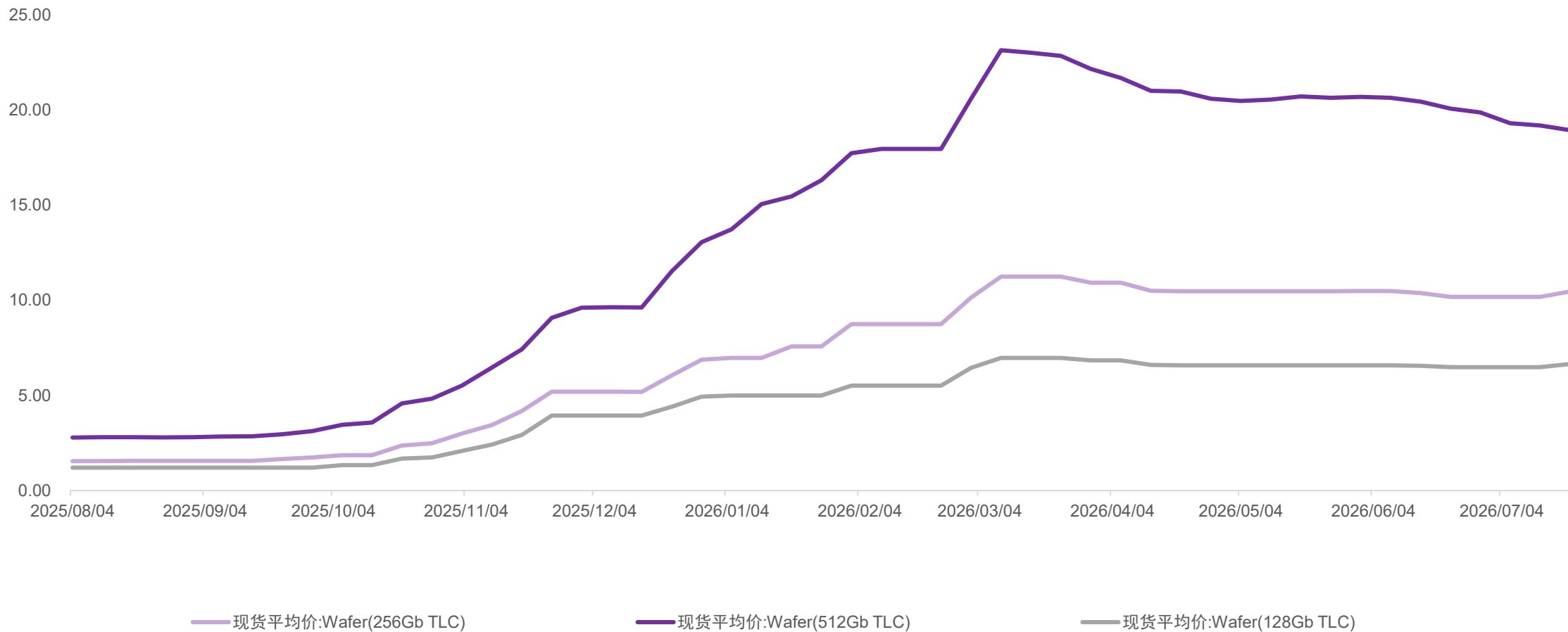
图表18：DRAM价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

图表19：NAND价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

03 行业动态

研究创造价值

三星宣布将在美国建1.4nm晶圆厂

据韩联社报道，三星电子于7月30日的第二季财报会议上宣布，预计今年底在美国德克萨斯州泰勒园区（Taylor）动工兴建第二座半导体晶圆厂“Taylor Fab 2”，目标是2030年量产1.4nm。

针对现有泰勒厂区的进度，三星电子指出，泰勒一厂（Taylor Fab 1）的建设正按原订时程顺利推进，预计于2026年正式营运。待一厂顺利投产后，将逐步扩大2nm制程产能。同时，随着客户对1.4nm先进制程的询问度不断攀升，三星透露目前也正在评估是否需要进一步增设晶圆厂，后续细节将按照客户订单状况与双方洽谈结果，采取分阶段方式进行规划。

在整体的产能策略布局上，三星电子强调，未来成熟制程将逐步过渡至更具获利能力的先进制程生产线，同时会将企业资源集中押注于技术门槛较高、附加价值更大的特殊制程产品上，借此持续优化产品结构与市场竞争力。

海光芯正锁定2027年度千万颗DSP芯片采购订单 夯实高速光互联供应链稳定性

7月31日，海光芯正发布自愿性公告，披露集团2027年度上游核心芯片采购业务最新进展。为进一步夯实供应稳定性，保障集团高速光互联产品长期生产交付能力，应对行业核心芯片供给紧张及价格波动风险，集团已与上游独立第三方核心芯片供应商落实2027年度芯片采购安排。

截至公告日期，集团针对安排于2027年度交付的DSP（数字信号处理器）芯片，已累计落实确定订单，合计采购数量约一千万颗。

本次采购订单对订约方均具有法律约束力，供应商将于2027年度分批次交付相关芯片。该芯片为支撑高速光模块高频带宽传输的核心元器件，提前锁定千万级核心芯片产能，体现集团前瞻的供应布局能力，有助保障集团原材料供应，有力支撑集团产能规划及满足下游客户交付需求。

三星：电机MLCC涨价30%，8月1日起生效

7月28日消息，据韩国媒体报道，三星电机近日已经向客户发布通知，受全球电子产业需求持续升温影响，供应链压力已超出公司可吸收范围，将自2026年8月1日起调涨积层陶瓷电容（MLCC）产品价格，调幅达30%。

三星电机表示，过去几个月全球电子产业需求出现结构性大幅成长，虽然公司持续投入资源提升制造效率并扩充产能，以满足市场需求，但供应链所承受的压力已超出公司所能吸收的范围。为维持产品品质与稳定供货，三星电机决定将调整部分产品售价。

此次调价适用于Samsung Electro-Mechanics Markup Business Code旗下所有MLCC产品，在现行价格基础上全面调涨30%，所有自2026年8月1日（含）起出货的产品均适用新价格。

三星电机在通知中强调，此次价格调整是不得已的措施，对于客户的理解与配合表达诚挚感谢。公司也承诺，未来仍将持续提供高品质产品，全力支持客户业务发展。

值得注意的是，全球前三大MLCC厂日商太阳诱电（Taiyo Yuden）也于7月27日传出，将调涨MLCC价格，拟于9月1日起生效，并强调“无法保证交期符合要求”。

太阳诱电表示，由于原材料价格持续高涨，公司已尽全力进行成本削减，但目前情况已达到无法仅靠自助努力吸收的程度，且继上次价格调整后，仍无法完全吸收成本压力，故决议自9月1日起，将进行价格调整。

04 公 司 公 告

研究创造价值

■ 华天科技:天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

根据天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)。

(一) 本次交易方案简介：

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电100%股份。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

(二) 交易详情：

本次交易标的为华羿微电子100%股权，交易价格为299,600.00万元。本次交易标的评估采用市场法，评估结果为299,600.00万元，较基准日账面价值增值率为166.17%。

(四) 本次重组的支付方式：

本次交易采用发行股份及支付现金方式购买华羿微电100%股权。其中，股份对价部分拟分两期发行，除华天电子集团外的交易对方一次性取得股份，华天电子集团股份支付部分分两期发行；现金对价部分由上市公司通过募集配套资金支付。

(五) 本次重组对上市公司财务及主营业务的影响：

本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、营业收入、利润总额、归属于母公司所有者净利润均将实现上升，最近一年的基本每股收益相比交易前略有上升。

本次收购华羿微电后，公司将拓展功率器件封装测试及自主品牌业务，完善集成电路产业布局，形成新的收入增长点，提升客户服务能力和核心竞争力。本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。

兆易创新科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告

根据兆易创新科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告。

（一）回购预案的主要内容：

回购方案首次披露日为2026年8月1日，实施期限为待公司股东大会审议通过后6个月；预计回购金额区间为10亿元~20亿元，资金来源为自有资金及/或自筹资金；回购价格上限750元/股，将采用集中竞价交易方式开展回购，计划回购股份数量区间为133.33万股至266.67万股，回购股份占公司总股本比例区间为0.19%~0.38%。

（二）回购目的：

公司基于对未来发展的信心，为维护股东利益、增强投资者信心，依法注销、减少注册资本。

（三）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股A股。

（四）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额：

本次回购的资金总额不低于人民币10亿元（含），不超过20亿元（含）。以公司目前总股本701,745,034股为基础，按照本次回购金额下限人民币10亿元，回购价格上限750元/股进行测算，本次拟回购数量约为133.33万股，约占公司目前总股本的0.19%；按照本次回购金额上限人民币20亿元，回购价格上限750元/股进行测算，本次拟回购数量约为266.67万股，约占公司目前总股本的0.38%。

本次回购自股东会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息等事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

上海富瀚微电子股份有限公司2026年半年度业绩预告

根据上海富瀚微电子股份有限公司2026年半年度业绩预告。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。

(二) 业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。

公司预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为27,000万元至35,000万元，同比增长1,072.72%至1,420.19%，上年同期盈利2,302.34万元；扣除非经常性损益后的净利润预计为26,600万元至34,600万元，同比增长1,640.93%至2,164.52%，上年同期盈利1,527.92万元。

二、业绩变动原因说明

公司预计2026年上半年实现营业收入14亿元—15亿元，同比增长103.48%—118.01%；实现归属于上市公司股东的净利润2.7亿元—3.5亿元，同比增长1,072.72%—1,420.19%。其中，二季度营业收入和归母净利润均创单季度历史新高。

业绩增长主要受益于全球电子行业景气度提升，存储价格上涨以及、电阻电容等上游原材料供应紧张推动产品价格上涨；同时，公司三大业务板块销售数量大幅增长，叠加产品价格提升，实现量价齐升。面对上游产能紧张及下游需求旺盛，公司通过优化供应链管理和丰富产品方案保障客户出货，新产品AI-ISP芯片市场反馈积极，机器人等新领域客户拓展稳步推进。长期来看，端边侧AI应用持续规模化落地，智能终端、边缘硬件等场景对AI技术的需求增长将进一步推动公司业务发展。

■ 宁波江丰电子材料股份有限公司关于参股公司增资进展及完成工商变更登记的公告

根据宁波江丰电子材料股份有限公司关于参股公司增资进展及完成工商变更登记的公告。

（一）基本情况

宁波江丰电子材料股份有限公司参股公司——北京丰科晶晟电子材料有限公司拟通过增资扩股方式引入员工持股平台及日本爱发科（ULVAC）等投资者。增资完成后，丰科晶晟注册资本由人民币8.92亿元增加至人民币13.5亿元，宁波江丰持有丰科晶晟股权比例由44.8430%下降至29.6296%，丰科晶晟仍为宁波江丰参股公司。2026年7月，宁波江丰与相关方签订变更协议，日本爱发科承接中国爱发科原认缴的3500万元出资份额，其对丰科晶晟的认缴金额由1亿元增加至1.35亿元。

（二）进展情况

近日，丰科晶晟已完成上述增资相关的工商变更登记手续，取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，主要信息如下：

- 公司名称：北京丰科晶晟电子材料有限公司（有限责任公司（外商投资、非独资））
- 注册资本：人民币元135,000万元
- 成立日期：2025年7月25日
- 经营范围：主要从事电子专用材料、电子元器件、显示器件及半导体设备等产品的研发、制造与销售，并涉及金属材料加工及进出口业务。

艾森股份:向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

根据江苏艾森半导体材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。

（一）发行基本情况

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过5.14亿元（含），债券期限为6年，每张面值100元，按面值发行。

（二）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（三）募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于：

- 电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）：项目总投资67,320.00万元，拟投入募集资金47,400.00万元；
- 补充流动资金：项目总投资4,000.00万元，拟投入募集资金4,000.00万元。

若扣除发行费用后的本次发行可转换公司债券实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。

■ 赛微电子:关于全资子公司实施股权激励计划的公告

根据北京赛微电子股份有限公司关于全资子公司实施股权激励计划的公告。

（一）子公司股权激励概述

赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司拟实施股权激励计划，首次授予对象包括部分董事、中高层管理人员及核心技术/业务人员，共85人。公司全资子公司北京微芯科技有限公司拟与激励对象设立合伙企业，并对北京极芯传感科技中心（有限合伙）增资，将其出资额由300万元增至10,526.32万元，激励对象通过合伙企业间接持有赛莱克斯北京股权。本次激励权益对应赛莱克斯北京4.75%股权（注册资本1亿元），授予价格为1元/份额。

（二）本次股权激励实施主体：赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司、北京极芯传感科技中心（有限合伙）

（三）股权激励计划主要内容

赛莱克斯北京拟实施股权激励计划，首次授予85名董事、中高层管理人员及核心技术/业务人员共10,000万份权益，对应公司注册资本4.75%。激励对象通过合伙企业间接持股，授予价格为1元/份额。首次授予考核期为2026—2028年，解锁与公司业绩及个人绩效考核挂钩。

（四）激励目的及影响

本次激励旨在吸引和留住核心人才，强化公司与员工利益绑定，推动赛莱克斯北京产能爬坡及业务发展。若权益全部授予，预计摊销费用总额约5,600万元（税前），不会导致公司合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

05 风 险 提 示

研究创造价值

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

庄宇：清华大学硕士，金融学&工科复合背景。10年科技行业研究经验。立足产业，做深入且前瞻的研究，主要覆盖AI硬件领域。

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券
CHINA FORTUNE SECURITIES

研创造价值